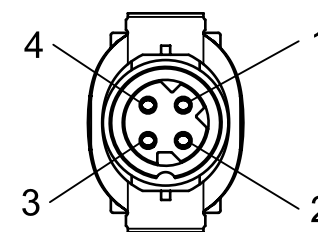


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.



Recommended solder paste thickness 150µm

1 Further information on soldering process and recommended layout, see brochure "Connectors for SMT production"

 DIN A3		document-no. / ri 102962944 / 00	article-no. / ri 1068454 / 09	scale 2:1	- Simplified representation - Linear dimensions (mm)
		date 2025-11-11	document-type TECDOC 2D-Productdrawing		
description SACC-CIP-M8FSD-4P SMD SH R32					
page	1	of	1		

- EN ISO 291 23/50